

平成23年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成22年11月11日

上場取引所 大

上場会社名 株式会社アバールデータ
 コード番号 6918 URL <http://www.avaldata.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長

(氏名) 嶋村 清

問合せ先責任者 (役職名) 管理本部部長

(氏名) 大関 拓夫

TEL 042-732-1000

四半期報告書提出予定日 平成22年11月15日

配当支払開始予定日

平成22年12月6日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有

(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期第2四半期の連結業績(平成22年4月1日～平成22年9月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
23年3月期第2四半期	3,464	102.0	269	—	307	—	216	—
22年3月期第2四半期	1,715	△44.7	△312	—	△232	—	△91	—

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
23年3月期第2四半期	29.20	29.09
22年3月期第2四半期	△11.93	—

(2) 連結財政状態

	総資産		純資産		自己資本比率		1株当たり純資産	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭	
23年3月期第2四半期	10,520	—	8,899	78.4	—	—	1,114.11	
22年3月期	10,824	—	9,224	79.3	—	—	1,158.73	

(参考) 自己資本 23年3月期第2四半期 8,253百万円 22年3月期 8,584百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
22年3月期	—	0.00	—	8.00	8.00
23年3月期	—	8.00	—	—	—
23年3月期 (予想)	—	—	—	10.00	18.00

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 無

3. 平成23年3月期の連結業績予想(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭	
通期	7,100	58.8	585	—	650	—	440	859.7	—	59.39

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 無

4. その他（詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 無
新規 一社（社名 ）、 除外 一社（社名 ）、

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 有
(注)簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

(注)「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年3月期2Q 8,064,542株 22年3月期 8,064,542株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q 656,375株 22年3月期 656,227株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年3月期2Q 7,408,232株 22年3月期2Q 7,649,867株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施しております。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、【添付資料】4ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報.....	2
(1) 連結経営成績に関する定性的情報.....	2
(2) 連結財政状態に関する定性的情報.....	3
(3) 連結業績予想に関する定性的情報.....	4
2. その他の情報.....	4
(1) 重要な子会社の異動の概要.....	4
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要.....	4
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要.....	4
3. 四半期連結財務諸表.....	5
(1) 四半期連結貸借対照表.....	5
(2) 四半期連結損益計算書.....	7
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書.....	8
(4) 継続企業の前提に関する注記.....	9
(5) セグメント情報.....	9
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記.....	10
4. 補足情報.....	11
(1) 生産、受注及び販売の状況.....	11

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や設備投資の持ち直し、また経済対策の効果などにより景気は緩やかに回復しつつあるものの、海外経済の減速や急激な円高進行の影響により企業収益の改善が弱まっており、依然として不透明な状況が続いております。

当社グループに関連深い半導体製造装置業界におきましては、前期後半から各種デジタル機器の需要が回復し、大手半導体メーカーの大型投資が再開されるなど、半導体製造装置市場の需要は、昨年比に比べ大幅な回復を持続しております。

このような経営環境のもと、当社グループは新規分野の顧客開拓や新製品投入を目指し、顧客の信頼を得る品質の確保とともに、コスト削減を含めた生産性の向上に取り組んでおります。

この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は3,464百万円（前年同四半期比102.0%増）、営業利益は269百万円（前年同四半期は312百万円の損失）、経常利益は307百万円（前年同四半期は232百万円の損失）、四半期純利益は216百万円（前年同四半期は91百万円の損失）となりました。

当社グループでは、事業内容を2つの報告セグメントに分けております。当第2四半期連結累計期間におけるセグメント別の状況は次のとおりであります。

① 受託製品

当該セグメントは、半導体製造装置関連、産業用制御機器及び計測機器の開発・製造・販売を行っております。当第2四半期連結累計期間は半導体製造装置関連の特に前工程の大幅な受注拡大により売上高は2,473百万円（前年同四半期比118.1%増）、セグメント営業利益は344百万円となりました。

当該セグメントの品目別売上の状況は次のとおりであります。

イ) 半導体製造装置関連

当該品目は、半導体製造装置の制御部を提供しております。半導体価格の回復、半導体メーカーの設備稼働率の改善により大手半導体メーカーの設備投資が再開され、昨年11月より受注の改善傾向が見られ、当第2四半期連結累計期間においてもさらに受注が増大したため、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は1,721百万円（前年同四半期比223.4%増）となりました。

ロ) 産業用制御機器

当該品目は、各種の産業用装置、分析機器等の制御部の開発・製造を行いカスタマイズ製品として提供しております。本年2月よりFA全般において受注に改善の兆しが見られ、本格的な回復に至らないものの売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は446百万円（前年同四半期比25.6%増）となりました。

ハ) 計測機器

当該品目は、各種計測機器のコントローラ、通信機器の制御部を開発・製造を行いカスタマイズ製品として提供しております。主力の電力関連機器全般の回復基調に加え、工業用計測機器の回復により、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は305百万円（前年同四半期比24.0%増）となりました。

② 自社製品

当該セグメントは、組込みモジュール、画像処理モジュール及び計測通信機器の開発・製造・販売並びにこれらに付属する周辺機器及びソフトウェア等の自社製品関連商品の販売を行っております。当第2四半期連結累計期間は組込みモジュール及び画像処理モジュールの受注拡大により売上高は990百万円（前年同四半期比70.5%増）、セグメント営業利益は155百万円となりました。

当該セグメントの品目別売上の状況は次のとおりであります。

イ) 組込みモジュール

当該品目は、半導体製造装置、FA全般、電力・通信関連向けに提供しております。FA全般の需要の急回復に加え、半導体製造装置関連の好転により、売上高は大幅に増加いたしました。

この結果、売上高は370百万円（前年同四半期比150.1%増）となりました。

ロ) 画像処理モジュール

当該品目は、FA全般、各種検査装置、液晶関連機器に提供しております。売上比率が高い液晶関連機器の設備投資の回復、FA全般が回復したことに加え、新分野での新製品の販売が貢献したことにより売上高は大幅に増加いたしました。

この結果、売上高は287百万円（前年同四半期比104.5%増）となりました。

ハ) 計測通信機器

当該品目は、超高速シリアル通信モジュール「GiGA CHANNEL」シリーズ、FAXサーバ・コールセンター向けCTI (Computer Telephony Integration) 及びリモート監視機器を提供しております。半導体製造装置業界及びFA全般は回復が進み、売上高は僅かながら増加いたしました。

この結果、売上高は261百万円（前年同四半期比3.7%増）となりました。

ニ) 自社製品関連商品

当該品目は、自社製品の販売促進とシステム販売による高付加価値化を図るため、ソフトウェア及び付属の周辺機器を提供しております。自社製品全般が回復に転じたことにより、売上高は増加いたしました。

この結果、売上高は70百万円（前年同四半期比78.5%増）となりました。

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 財政状態の分析

(資産)

当第2四半期連結会計期間末における資産は10,520百万円（前連結会計年度末に比べ303百万円の減少）となりました。

流動資産につきましては、主に、現金及び預金が131百万円増加、業績の回復を背景に受取手形及び売掛金が219百万円増加、商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品これらのたな卸資産が194百万円増加、その他が14百万円増加した結果、559百万円増加し6,936百万円となりました。固定資産につきましては、積極的な設備投資は行っておらず、主に、減価償却により有形固定資産が34百万円減少、無形固定資産が8百万円減少、投資その他の資産が投資有価証券の時価変動等の影響により820百万円減少した結果、863百万円減少し3,584百万円となりました。

(負債)

当第2四半期連結会計期間末における負債は1,621百万円（前連結会計年度末に比べ20百万円の増加）となりました。

流動負債につきましては、主に、原材料等の購入増加に伴い支払手形及び買掛金が149百万円増加、未払法人税等が66百万円増加、賞与引当金が91百万円増加、役員賞与引当金が6百万円増加、その他が未払消費税及び未払費用の増加等により37百万円増加した結果、351百万円増加し1,243百万円となりました。固定負債につきましては、主に、その他が繰延税金負債の減少により332百万円減少した結果、330百万円減少し377百万円となりました。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産は8,899百万円（前連結会計年度末に比べ324百万円の減少）となりました。

主に、利益剰余金が157百万円増加、その他有価証券評価差額金が487百万円減少したことが要因となります。

なお、当第2四半期連結会計期間末における自己資本比率は78.4%（前連結会計年度末に比べ0.9ポイントの減少）となりました。

② キャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、2,786百万円（前連結会計年度末に比べ31百万円の増加）となりました。

また、当第2四半期連結累計期間におけるフリー・キャッシュフローは、94百万円の増加（前年同四半期は346百万円の増加）であります。

営業活動、投資活動及び財務活動によるキャッシュ・フローの主な内容は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、174百万円の増加（前年同四半期は289百万円の増加）となりました。

主に、税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上、仕入債務及び賞与引当金の増加等の増加要因が、売上債権、たな卸資産及び未収入金の増加等の減少要因を上回ったことによる増加となります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、80百万円の減少（前年同四半期は56百万円の増加）となりました。

主に、定期預金の払戻、投資有価証券の売却による収入等といった増加要因を、定期預金の

預入、有形固定資産の取得等といった減少要因が上回ったことによる減少となります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、62百万円の減少（前年同四半期は167百万円の減少）となりました。

主に、配当金の支払等の減少要因によるものです。

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

今後の見通しにつきましては、平成22年5月14日付「平成22年3月期 決算短信」に公表いたしました業績予想及び配当予想を平成22年9月14日に修正発表を行っております。

なお、本資料に記載した業績予想等は、概ね計画通りに推移しており、平成22年9月14日に公表した数値からの変更はございません。

また今後、当社グループを取り巻く環境が著しく変化した場合等、業績に影響を及ぼす事態が生じた場合には速やかに適時開示を行います。

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

該当事項はございません。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

① 棚卸資産の評価方法

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

該当事項はございません。

3. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	当第2四半期 連結会計期間末 (平成22年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,576,600	3,444,975
受取手形及び売掛金	1,393,718	1,174,577
有価証券	10,145	10,140
商品及び製品	261,564	283,928
仕掛品	335,467	292,472
原材料及び貯蔵品	845,704	671,676
その他	513,564	499,498
流動資産合計	6,936,765	6,377,269
固定資産		
有形固定資産		
土地	1,316,699	1,316,699
その他(純額)	1,004,713	1,038,862
有形固定資産合計	2,321,413	2,355,562
無形固定資産	55,180	63,620
投資その他の資産		
投資有価証券	1,143,646	1,963,334
その他	94,536	95,566
貸倒引当金	△30,593	△30,653
投資その他の資産合計	1,207,589	2,028,246
固定資産合計	3,584,183	4,447,430
資産合計	10,520,948	10,824,700
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	849,210	699,515
未払法人税等	81,642	15,623
賞与引当金	191,981	100,521
役員賞与引当金	6,228	—
その他	114,499	76,714
流動負債合計	1,243,562	892,375
固定負債		
退職給付引当金	92,253	90,770
役員退職慰労引当金	77,030	77,030
その他	208,257	540,422
固定負債合計	377,540	708,222
負債合計	1,621,103	1,600,598

(単位：千円)

	当第2四半期 連結会計期間末 (平成22年9月30日)	前連結会計年度末に係る 要約連結貸借対照表 (平成22年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	2,354,094	2,354,094
資本剰余金	2,459,689	2,459,689
利益剰余金	3,341,654	3,184,580
自己株式	△277,538	△277,459
株主資本合計	7,877,899	7,720,905
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	375,585	863,305
評価・換算差額等合計	375,585	863,305
新株予約権	7,738	5,527
少数株主持分	638,622	634,364
純資産合計	8,899,845	9,224,102
負債純資産合計	10,520,948	10,824,700

(2) 四半期連結損益計算書
(第2四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)
売上高	1,715,414	3,464,399
売上原価	1,340,006	2,409,375
売上総利益	375,407	1,055,023
販売費及び一般管理費	687,809	785,438
営業利益又は営業損失(△)	△312,401	269,584
営業外収益		
受取利息	2,095	1,208
受取配当金	34,739	33,094
助成金収入	30,537	—
その他	12,857	3,543
営業外収益合計	80,229	37,846
営業外費用		
為替差損	—	1
支払手数料	432	—
営業外費用合計	432	1
経常利益又は経常損失(△)	△232,605	307,429
特別利益		
固定資産売却益	—	300
投資有価証券売却益	69,228	51,965
その他	70	60
特別利益合計	69,298	52,325
特別損失		
固定資産除却損	589	32
特別損失合計	589	32
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△163,896	359,722
法人税、住民税及び事業税	8,306	76,288
法人税等調整額	△77,170	59,085
法人税等合計	△68,864	135,374
少数株主損益調整前四半期純利益	—	224,348
少数株主利益又は少数株主損失(△)	△3,752	8,007
四半期純利益又は四半期純損失(△)	△91,279	216,340

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

	前第2四半期連結累計期間 (自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日)	当第2四半期連結累計期間 (自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)	△163,896	359,722
減価償却費	85,545	76,371
賞与引当金の増減額(△は減少)	32,680	91,459
役員賞与引当金の増減額(△は減少)	—	6,228
退職給付引当金の増減額(△は減少)	1,688	1,483
受取利息及び受取配当金	△36,834	△34,303
助成金収入	△30,537	—
固定資産除却損	589	32
固定資産売却損益(△は益)	—	△300
有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益)	△69,228	△51,965
売上債権の増減額(△は増加)	50,221	△219,140
たな卸資産の増減額(△は増加)	181,247	△194,658
未収入金の増減額(△は増加)	37,072	△94,652
仕入債務の増減額(△は減少)	16,997	149,695
未払消費税等の増減額(△は減少)	2,466	23,763
その他	△4,320	6,585
小計	103,692	120,320
利息及び配当金の受取額	36,697	34,265
助成金の受取額	12,837	20,658
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)	136,356	△679
営業活動によるキャッシュ・フロー	289,584	174,564
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△200,000	△400,000
定期預金の払戻による収入	200,000	300,000
投資有価証券の取得による支出	△1,000	—
投資有価証券の売却による収入	69,645	52,382
有形固定資産の取得による支出	△3,623	△28,501
無形固定資産の取得による支出	△9,000	△5,058
その他	709	929
投資活動によるキャッシュ・フロー	56,731	△80,247
財務活動によるキャッシュ・フロー		
自己株式の取得による支出	△102,032	△79
配当金の支払額	△61,914	△58,858
少数株主への配当金の支払額	△3,750	△3,750
財務活動によるキャッシュ・フロー	△167,696	△62,687
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	178,619	31,629
現金及び現金同等物の期首残高	2,659,344	2,755,116
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,837,963	2,786,745

(4) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間（自平成21年4月1日至平成21年9月30日）
連結グループは、産業用コンピュータ及び周辺装置の開発、製造、販売のみを行っており、単一の事業分野での事業活動を行っているため、記載を行っておりません。

【所在地別セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間（自平成21年4月1日至平成21年9月30日）
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

【海外売上高】

前第2四半期連結累計期間（自平成21年4月1日至平成21年9月30日）
海外売上高は連結売上高の10%未満のため、その記載を省略しております。

【セグメント情報】

（追加情報）

第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号平成20年3月21日）を適用しております。

1 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、産業用電子機器の開発・製造・販売を行っており、組込・画像・通信・A/D変換の総合力により受託製品及び自社製品として営業展開しております。

したがって、当社は営業展開の意思決定等を実施する上で重要な管理単位となる「受託製品」及び「自社製品」の2つを報告セグメントとしております。

「受託製品」は、半導体製造装置関連、産業用制御機器及び計測機器の開発・製造・販売を行っております。「自社製品」は、組込みモジュール、画像処理モジュール及び計測通信機器の開発・製造・販売並びにこれらに付属する周辺機器及びソフトウェア等の自社製品関連商品の販売を行っております。

2 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

当第2四半期連結累計期間（自平成22年4月1日至平成22年9月30日）
（単位：千円）

	受託製品	自社製品	合計
売上高			
外部顧客への売上高	2,473,939	990,459	3,464,399
セグメント間の内部売上高又は振替高	—	—	—
計	2,473,939	990,459	3,464,399
セグメント利益	344,714	155,661	500,375

3 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項）

当第2四半期連結累計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

（単位：千円）

利 益	金 額
報告セグメント計	500,375
セグメント間取引消去	—
全社費用（注）	△230,791
四半期連結損益計算書の営業利益	269,584

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

4. 補足情報

(1) 生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	442,980	△42.6	1,268,026	186.2
産業用制御機器	317,679	△42.9	384,606	21.1
計測機器	123,764	△32.0	222,055	79.4
小計	884,423	△41.4	1,874,687	112.0
自社製品				
組込みモジュール	86,030	△55.0	226,494	163.3
画像処理モジュール	63,329	△58.0	116,483	83.9
計測通信機器	160,647	△3.7	105,185	△34.5
小計	310,007	△39.1	448,162	44.6
合計	1,194,431	△40.8	2,322,850	94.5

- (注) 1 金額は製造原価にて表示しております。
 2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。
 3 自社製品セグメントにおいては、記載した詳細品目に付属する周辺機器の提供として、自社製品関連商品の販売を行っておりますが、当該仕入実績は、② 商品仕入実績として別途記載しております。

② 商品仕入実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
自社製品				
自社製品関連商品	22,858	△82.4	64,160	180.7
小計	22,858	△82.4	64,160	180.7
合計	22,858	△82.4	64,160	180.7

- (注) 1 金額は仕入価格にて表示しております。
 2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

③ 受注状況及び販売状況

イ) 受注高

セグメントの名称 及び詳細品目	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	612,323	△41.7	1,573,805	157.0
産業用制御機器	362,415	△28.4	428,583	18.3
計測機器	268,809	△38.5	331,418	23.3
小計	1,243,547	△37.6	2,333,807	87.7
合計	1,243,547	△37.6	2,333,807	87.7

ロ) 受注残高

セグメントの名称 及び詳細品目	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	146,462	△19.7	317,971	117.1
産業用制御機器	163,223	△16.3	208,250	27.6
計測機器	88,073	△37.3	160,742	82.5
小計	397,759	△23.2	686,965	72.7
合計	397,759	△23.2	686,965	72.7

ハ) 販売実績

セグメントの名称 及び詳細品目	前第2四半期連結累計期間 (自平成21年4月1日 至平成21年9月30日)		当第2四半期連結累計期間 (自平成22年4月1日 至平成22年9月30日)	
	金額(千円)	前年同四 半期比(%)	金額(千円)	前年同四 半期比(%)
受託製品				
半導体製造装置関連	532,512	△50.0	1,721,923	223.4
産業用制御機器	355,912	△34.9	446,968	25.6
計測機器	246,039	△38.3	305,047	24.0
小計	1,134,464	△43.6	2,473,939	118.1
自社製品				
組込みモジュール	148,137	△52.2	370,494	150.1
画像処理モジュール	140,535	△53.5	287,431	104.5
計測通信機器	252,757	△23.0	261,985	3.7
自社製品関連商品	39,519	△73.3	70,547	78.5
小計	580,949	△46.7	990,459	70.5
合計	1,715,414	△44.7	3,464,399	102.0

(注) 1 金額は販売価格にて表示しております。

2 上記の金額には消費税等は含まれておりません。

3 第1四半期連結累計期間よりセグメントに関連付けて記載しているため、前第2四半期連結累計期間の記載方法と異なりますが、記載した金額に影響はありません。

4 受注高及び受注残高は受託セグメントの内容であり、自社製品セグメントにおいては、需要予測に基づく見込生産を行っているため、該当事項はありません。